# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

64-047019

(43)Dat of publication of application: 21.02.1989

(51)Int.CI.

H01L 21/205 H01L 21/31

(21)Application number: 62-204777

(71)Applicant:

DENKI KAGAKU KOGYO KK

(22)Date of filing:

18.08.1987

(72)Inventor:

**OGATA YOICHI** KOBAYASHI AKIRA

TERASAKI RYUICHI **NOZAWA KAZUMI** SATO SHINSEI

### (54) GLASSY CARBON COATED SUSCEPTOR

PURPOSE: To enable a thin film formed on a susceptor by a CVD process to be hardly peeled off by a method wherein the surface roughness of a susceptor comprising a carbonic material coated with a glassy carbon is specified.

CONSTITUTION: The mean surface roughness Ra of a susceptor is specified to be 0.1μmW5μm while the maximum surface roughness Rmax is specified to be 1μmW50μm. In order to coat a carbonic base material with a glassy carbon, the carbonic material is coated with organic high molecule as a carbonic precursor to be baked in a non-oxidative gas or vacuum. The organic high molecule is recommended to have the carbon content exceeding 30 weight % while the carbonic base material is recommended to be a mold in density of 1.6W2.1g/cm2 or isotropic graphite. At first, a carbonic base material in the mean surface roughness Ra of 0.1μmW5μm and the maximum surface roughness Rmax of 1μmW50μm is used to coat the surface thereof with a glassy carbon to be a susceptor and then the mean surface roughness Ra and the maximum surface roughness Rmax are measured to determine the optimum surface roughness of the base material making reference to the results.

## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

#### ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭64-47019

Solnt Cl.4

識別記号

庁内整理番号

43公開 昭和64年(1989)2月21日

H 01 L 21/205 21/31

7739-5F 6708-5F

未請求 発明の数 1 審査請求 (全4頁)

69発明の名称

ガラス状炭素被覆サセプター

创特 昭62-204777

**22**HH 昭62(1987)8月18日

形 陽 東京都町田市旭町3丁目5番1号 電気化学工業株式会社 @発 明 者 尾 中央研究所内 晃 ⑦発 眀 渚 小 林 東京都町田市旭町3丁目5番1号 電気化学工業株式会社 中央研究所内 経 電気化学工業株式会社 眀 寺 崎 東京都町田市旭町3丁目5番1号 伊発 者 中央研究所内 東京都町田市旭町3丁目5番1号 電気化学工業株式会社 @発 明 老 氍 沢 和 己 中央研究所内 勿発 眀 者 佐 新 世 東京都町田市旭町3丁目5番1号 電気化学工業株式会社

中央研究所内

仍出 阻 電気化学工業株式会社 東京都千代田区有楽町1丁目4番1号

#### 睭 細

#### 1. 発明の名称

ガラス状炎素被覆サセプター

### 2.特許請求の範囲

**炭素基材の表面にガラス状炭素を被覆してたる** サセプターにおいて、該サセプターの平均表面租 さ Ra が D・1 ##以上 5 ##以下で、最大表面粗さ R<sub>max</sub> が 1 A# 以上 5 0 AM 以下であることを特徴 とするガラス状炭素被覆サセプター。

### **る発明の評細な説明**

〔舜楽上の利用分野〕

本発明は、たとえば半導体の製造工程において 使用されるサセプターに関する。

## 〔従来の技術〕

一般にサセプターはシリコンウエーハー等の半 身体材料を直接敵性し、エピタキシャル気相成長 や各種避嫌膜の気相成長等を行う際に使用される。 従つて、再組度であること、耐熱性の高いこと、 耐脳女性の使れていることなどが要求される。

これらの要求に応えるものとして従来から提案

基材の上に化学気相震着( CVD )法による炭化硅 集を被覆したサセプターが使用されている(参考 文献例:特別昭56-10921号公報)。しか し炭化硅量被悪サセプターは炭化硅電補務層と炭 \*基材との熱影張係数が異なつているために繰り 返し使用による熱サイクルで、被覆層にクラック が発生し、そのクラックを造して炭素基材から不 純物が参ふだし製品を背架するという欠点を有し ていた。さらに、皮化硅素被覆層は CVD 法により 形成されるため鉄の均一性が劣り、ピンホールが 発生しやすいので、近年とみに虫求が高まりつつ あるサセプターの大型化に対応することが困難で あるという欠点があつた。

これらの欠点を捕り手段として、炭素基材にガ ラス状炭素を被覆する提業がある(特公昭52-る9684号公報)。この方法で待られるガラス 状炭素板罐サセプターは、上配炭化硅累被罐サセ プターと比較して被整層の均一性が優れており、 また被膜脂の気体通気率が2桁程度小さいので、 炭素基材からの不純御の汚染を減少できるという

(2)

、利点を有している。

しかしながら、サセプターを CVD 法化よる各種 絶縁膜形成時のウェハー戦 動台として使用してい ると、サセプターの表面にも CVD 化よる善度が生 成し、この薄膜の剥離による障害が発生する。た とえば 8102 絶数膜の場合は 5 回程度または 1 G pm 程度 CVD を行うと、サセプター上に生成した 8102 海膜が剥離を起こし易くなりダスト発生の 無因となる。これを防ぐためにしばしばエッテン が(複類除去作業)を行いサセプター上に生成し た神膜を除去しなければならないという欠点があった。

[発明が解決しようとする問題点]

本発明の目的は、サセプター上に CVD 法により 形成される神膜が剥削し難いガラス状状素を遵サ セプターを提供することにある。

[問題点を解決するための手故]

発明者は各種材料の CVD を行つたとき、チャプ ター上に生成する薄膜の剥離によるダストの発生 が CVD の回数に対してはらつきのあることに気付

単に被膜を形成できる。特にガラス状段素を整体の便逸が半導体用治典、サセプター等の場合には、不納物の面からがり塩化ビニルを熱分解させた PCがとりわけ好ましい。熱分解は、不活性気体中で200~500℃で30分以上加熱して行な

前記PCを新剤に100~8008/18の過度 で帯かして炭素基材に塗布するが、新剤としては 潜解性、揮発性の点でトリクレンなどの脂肪疾塩 素系のものが好ましい。塗布方法は超音波含浸、 はけ塗り、スプレー、浸漬などでよく、塗布後に 比較的低温(50~150℃程度)で乾燥することが好ましい。ついて、非酸化性気体中またな真 空中で600~1300℃程度の温度で30分以 上焼成する。

炭素基材は、その用途がサセプターであることから、加工物度、通気率等を考慮すると、密度 1.6~2.1 *8/ cm³ のモールド*または等方性愚鉛が好ましい。サセプターの表面祖さを削配の通りにするために、炭素基材の表面祖さの調整が重要

き、これを検討した結果、サセプターの表面組さ と関連のあることを見出した。 丁なわち本発明は、 炭素基材の表面にガラス状炭素を被覆してなるサ セプターにかいて、 飲サセプターの平均表面組さ Ra が 0.1 Am 以上 5 Am 以下で、 量大表面組さ Ratx が 1 Am 以上 5 0 Am 以下であることを特徴 と丁るガラス状炭素を複サセプターである。

である。サセプターの表面粗さは炭素基材の表面 粗さとはは同じになるが、ガラス状炭素の被種の 条件によつて多少変る。したがつて、まず平均表 面組され。が 0.1 Am ~ 5 Am 、 放大表面担されるが、 が 1 Am ~ 5 0 Am 程度の炭素基材を用いて、 表面にガラス状炭素を被覆してサセプターと、 その平均表面担さを炭素面担さを定めれば、 を発素を対の表面担さを定めれば、 により最適な基材の表面担さを定めれば、 により最適なを変更しない。 炭素基材の表面担さを変更しない。 炭素をでの加工、研修による表面研修、サントなどでよい。

サセプターの平均表面組さ Ra は O・1 Am 以上 5 Am 以下、好ましくは O・5 Am 以上 3 Am 以下で、かつ最大表面組さ Rmax は 1 Am 以上 5 Q Am 以下、かつ最大表面組さ Rmax は 1 Am 以上 5 Q Am 以下、このましくは 5 Am 以上 3 Q Am 以下である。 Ra が O・1 Am 未満 であると、サセプター 妥面 化生成 した CVD 特膜が 初離 し易くなる。また、 Ra が 5 Am を越えると、または Rmax が 5 Q Am 総えるとサセプターからウェハーへの 伝熱が不均一になり、ウェハー上に生成する CVD

(3)

· 膜の均質性が悪くなる。

#### . 〔 突 旌 例 〕

以下、実施例により本発明を具体的に説明する。 実施例1~10及び比較例1~6

炭素基材として市販の等方性風鉛 8IC - 6(東洋炭条製)を用い、直径 2 5 0 mm、 厚さ 1 0 mmの 円板状に加工したのち、サンドプラストまたにサンドペーパーにより表 1 化示す 1 6 種類の表面粗されて対した。表面粗されて対した。表面粗されて対した。を引い、JIS B - 0 6 0 1 にしたがつて過音を洗りのとなるで、1 8 0 0 ℃、アルコン雰囲気下で一時間焼成した。

いつぼう有機高分子として、電気化学工業(株) 製の塩化ピニル樹脂(88-110)を登录気中 390℃、90分熱分解して得られたPCを用い た。このPCをトリクレンに普解し、機度20% のPC治被を調表した。このPC語派に上記各基 材を超音波浸渍したのち乾燥し、その後アルゴン

分布についても断面収象により調べた。その結果 を表2に示す。

表2を見ると分るようにサセプター表面のRaがO.1 Am未満、またはRmaxが1 Am未満であると(比較例1~3)、CVDの図数は10回未満では膜面にクラックや剥離が認められた。しかし薄膜の均一性は膜障偏差を見ると分るように実施例と同様使れていた。これに対し、Raが5 Amを超えると(比較例4~6) CVDの回数は50回でも薄膜面にクラックや剥離は認められず、ポストの発生も認められなかつたが、薄膜の均一性の点でかたのちょとが分る。なお、シリコンウェハーは剥離が生じた場合を徐き鏡面状態を保つていた。

雰囲気下1200℃で一時間焼成して、ガラス状 炭素被機サセプターを得た。得られたサセプター の平均表面担さかよび最大表面担さは表1に示す とかりである。

このようにして作成したサセプターをプラズマCVD 装世(サムコインターナショナル製M del PD - 1 ①) に装着し、さらに該サセプター上に 直径2 インチのシリコンウェハーを置き、表 2 に 示す条件で銀化ケイ素または酸化ケイ素の CVD を行立つた。なか、いずれの場合もプラズマ発生用 電力の周波数は 1 3.5 6 MBs、出力は 7 ① W、サセプターの温度は 3 5 0 ℃であつた。 得られた CVD 非験の厚さは表 2 に示すとか 9 である。

CVD を終えた後サセプター及びシリコンウェハー上の表面破裂を目視及び組改鏡で行つた。シリコンウェハーは CVD を終えるごとに毎回交換したが、サセプターは接面観象後何の処理もせずに再歴 CVD に用いた。そして、何回の CVD でサセプター表面の移與にクラックや剥離が発生するかを調た。また、シリコンウェハー上の CVD が終の旋停

表 1

		炭素基材の表 強粗さ		サセプターの表面包さ		サセプター上のCVD神楽上 セタラッタまたは製能が発 生するまでのCVD 函数		シリコンウエハー上1 0 復所の存装の原準の 条準偏差 ( με )	
		Ra(##)	RRAZ(AR)	Ra(an)	Bues (Am)	SIN	810:	811	8102
突施例	1	0.1	1.0	0.1	1.0	18	1 3	0.017	0.032
	2	0.1	2-5	0.1	2.0	16	1 3	0.012	0.028
	3	0.5	1-5	0.5	1.5	2 3	1 7	0.015	0-031
	4	0.5	3.5	0.5	3.5	22	19	U-018	0.029
	5	1.0	3.5	1.0	3.0	31	26	U-018	0.035
	6	-1-0	8-0	1.0	8.0	4.5	40	0.017	0.038
	7	3·0	8-5	3.น	8.5	50以上	4 3	0.016	U-037
	В	3.0	2 U	3.0	2 0	48	50以上	U-U1B	0.037
	9	5.0	1 5	5.U	1 5	50以上	48	0.023	0-042
	1 0	5.0	5.0	5.0	5 0	50以上	50以上	0.026	0.040
比 歌 例	1	0.08	1.0	D-08	0.5	2	3	0.013	0.030
	2	0-08	1.0	0.08	1.0	3	3	U.015	0.029
	3	0.1	0.5	0.1	0.5	7	5	U.Q15	0-031
	4	5-0	7 0	5.0	7 0	50以上	48	0.093	0.153
	5	7-0	4 B	7-0	4 0	50以上	50以上	0.138	0.237
	6	7-0	<del>-5-5</del> 75	7.0	7 5	50以上	50以上	0.213	0.335

**委** 2

-	BIN O CAD	81020CVD
使用ガスの種類	81H - NH 5	Sin - NgO
ガスのモル比	1 : 20	1 : 25
ガスの圧力 (torr)	0.9	1.0
CVD 速度(AM/分)	0-04	0.06
CVD時間 (分)	20	20
CVD 存膜の序さ(メ=)	0.8	1.2

制機によるダスト発生のおそれがない。このため、CVD 作業に本発明のサセプターを用いると、エクチングの回数を大幅に該らすことができる。

将許出顧人 电気化学工架株式会社

## [発明の効果]

以上の説明から明らかなように、サセプターの 表面組さの Ra が O.1 Am 以上 5 Am 以下、 Rmax が 1 Am 以上 5 D Am 以下に関係された本発明のサ セプターは、 CVD 法によりその設面に生成する薄 製の付着力が数固であり、剥離し難いので、被減